4. 公司产品和能力契合度

不同的客户往往在产品、质量要求、技术响应支持、供应链上会有不同的要求。因此客户的分级及选择也要综合考虑芯片公司自身的研发能力、销售渠道、技术支持、供应链能力等因素与客户要求的匹配度。

从产品契合度上考虑，大部分的芯片公司，尤其是中小规模的芯片公司，往往只是在某几个芯片产品类别上具有出色的研发实力。客户所需要的产品，可能并不是公司的研发能力可以覆盖的，甚至有较大的差距。作为芯片销售，从客户处获得产品机会时，一定要考虑公司自身研发的能力，能对公司产品规划起到牵引和指导的作用，也可以对研发能力有一定的挑战性，但不能远远超过现有的研发能力。对于远远超过现有研发能力的产品机会，最终无法转变为实质的合作与业绩。

出色的芯片销售所拿到的客户产品合作机会，应该首先是在公司现有研发能力的雷达之中的。同时，对于客户所需要的产品，公司最好也有持续进行研发投入、实现产品迭代升级的规划。在这样的产品契合度下，才能在公司与客户之间加深合作，而不是一锤子买卖。公司的芯片产品类别与客户的终端产品中需要使用的芯片类别重叠度越高，就越能扩展合作的宽度。

从能力契合度的维度，芯片公司需要充分评估自身的非产品能力能否满足客户的需求。例如技术响应支持，有的客户本身的技术能力较为出色且研发人员资源充裕，对于供应商本身的技术支持要求就较低，而其他的一些客户可能需要供应商提供全方位的软件及硬件技术支持。有的客户对芯片供应商的供应链布局也会有要求，例如需要双晶圆厂备份或者晶圆厂必须有海外厂商等要求。一些客户也需要芯片供应商具有完整的质量管理体系，具备直供的交付能力等等。

2.2.2 销售人员如何高效分配精力

在对市场、客户、竞争格局、公司自身实力四个维度进行洞察和分析后，芯片公司可以梳理出匹配公司当前及未来产品规划的重点客户群，并对客户群进行分级管理，形成大客户、重点客户和大众市场客户等不同属性的客户。以客户分级为基础，进行销售资源的分配，是提升公司销售产出的有效途径。对大客户和重点客户，更需要持续理解客户的发展规划，关注增长机会，制订行动计划，从而实现将销售资源优先投入到回报最大化、最持续的客户中。更进一步，应将销售资源投入到客户的关键项目中，关键项目能够带来的不仅仅是业绩营收的回报，也包括客户关系、公司品牌、新产品验证机会等。

1. 销售资源匹配客户分级

在对客户进行了明确的分级后，以资源匹配客户级别为原则，芯片公司销售管理层在进行销售资源的分配时就可以有明确的优先级。通常芯片销售、现场应用工程师、客户服务代表、客户质量工程师以及研发资源都应向战略大客户及重点客户倾斜。

客户分级是为了更加高效地利用芯片公司内部的有限资源，因此对于销售和现场应用工程师的人员数量安排，要充分体现公司对客户合作规模成长性的预期。对于高潜力客户及客户中的高潜力项目所需要投入的人员数量以及人员能力要着重考虑，匹配能力最强的销售及现场应用工程师。同时，应考虑现场应用工程师与销售的搭档协同，形成有效的作战单元。要保持与客户对接的销售人员的稳定性，以便持续加深客户关系。对于类似华为、联想这样的客户，横跨不同市场，由不同的事业集团（Business Group，BG）组成，因此对

3.1.3　发现客户项目上的机会点

在发现了客户项目之后，下一步的重点工作是挖掘客户项目上的机会点。在芯片行业，项目上的机会点通常称为 Socket。在销售芯片产品的过程中，机会点通常可以分为两类，即“替代机会”和“新产品机会”。中小芯片公司往往从开发芯片替代产品开始，逐步走向新产品的定义和开发。

替代产品的开发主要对标欧美厂商已有的成熟芯片产品，目标明确，核心是确保芯片产品性能的稳定性和可靠性。替代产品通常面临较大的市场竞争压力，产品的盈利能力较弱。新产品开发主要基于客户终端产品新的应用需求，需要芯片公司能够很好地理解客户需求，并定义芯片规格参数，偶尔还会面临市场需求的不确定性。但这类产品通常没有现存的竞品，盈利能力较强，而且更能提升芯片厂商在客户心中的研发实力认可度。

项目是客户终端产品开发的载体，是实现终端产品的过程，项目机会点是以终端产品为基础来进行分析和讨论的。对于具体的终端产品，我们可以用系统方框图的形式来展现组成终端产品的各个模块之间的连接关系，以及各个模块内部所需的、实现特定功能的芯片。

德州仪器官网展示的有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode，OLED)电视系统方框图如图 3.2 所示。从图中我们可以清楚地了解 OLED 电视的硬件组成，包括开关模式电源板(Switched-Mode Power Supply Board，SMPS Board)、有线接口(Wired Interface)等模块。每一个模块内部需要有一颗或若干颗实现特定功能的芯片，例如通用串行总线限流芯片(Universal Serial Bus Current Limit，USB Current Limit)、通用串行总线再驱动芯片(USB Redriver)等。方框图中的每一颗实现特定功能的芯片就是一个机会点。

如果 A 芯片公司有能够匹配方框图中功能需求的一颗或多颗芯片产品，例如 A 芯片公司可以提供实现通用串行总线限流功能的芯片，那么就可以说 A 芯片公司在 OLED 电视这个终端产品中有一个机会点。芯片种类越丰富、产品数量越多的公司，在某个具体的终端产品上的机会点会越多，芯片销售就应该越重视客户项目上机会点的挖掘和识别。

因此，对客户所开发终端产品的系统方框图进行详细的分析，确认终端产品中所需的每一个芯片，是发现客户项目机会点的基础。具体而言，可以从如下两个方面来尽可能挖掘客户项目上的每一个机会点。

1. 分析客户终端产品的物料清单

在实际的销售过程中，最直接、简单的发现机会点的做法是从客户处了解到客户终端产品的物料清单(Bill of Materials，BOM)。物料清单中详细罗列了客户终端产品所使用的芯片型号，并描述了芯片对应的功能。然后芯片销售结合自己公司的芯片产品系列，评估是否有能够直接进行替换的芯片产品，如果有，那么就是一个机会点。

在前些年，国产替代热度很高，一些国内的芯片公司会开发与欧美芯片厂商管脚兼容(Pin to Pin，P2P)的芯片。两颗芯片的管脚完全一致，客户可以实现直接的替换，不需要修改芯片外围的元器件，甚至驱动或软件程序都可以直接复用，大大降低了客户的工作量。这些能够实现管脚兼容的芯片，甚至在芯片型号上也与替换对象大致相同，方便客户记忆和理解其替换目标。这一类的机会点就是“替代机会”。

简单地根据客户终端产品物料清单中的芯片型号进行机会点的寻找虽然简单高效，但

线同步相关机会点的情况，供内部产品线评估，为产品线未来的产品规划提供参考。

对于某些机会点，芯片销售可以联合有类似芯片需求的其他销售团队，一同梳理该芯片的市场需求用量、主力客户群、竞争态势，一起推动产品线对该机会点进行评估和投入。例如，A 销售支持甲手机客户，B 销售支持乙手机客户。当 A 销售发现自己的客户未来在手机产品的开发中会用到一颗新的芯片产品，但自己客户的芯片年用量有限，商业回报不足以覆盖产品线对该芯片产品的研发投入时，A 销售就可以主动与 B 销售以及与公司内部其他手机客户销售沟通，如果其他手机客户也有类似的需求，那么可以将多个客户的需求进行汇总分析，这样芯片的潜在价值就有机会引起内部产品线的重视，从而投入研发资源进行开发。

正如我们在第 1 章中所提到的，芯片销售偶尔也是市场经理，发掘市场机会，引导和协助内部的芯片产品开发，开发后的芯片又能提供给客户选用，从而持续不断地加深与客户的合作。芯片销售不能简单地、单向地接收内部的芯片产品，有什么卖什么。

芯片销售处于市场和客户的一线，能够感受到市场和客户需求的趋势变化，要对新的机会点保持高度敏感。尤其是中小规模的芯片公司，往往内部产品线专职的市场经理人数较少，更需要芯片销售承担市场经理的职责，和内部产品线加强信息沟通，把握客户项目机会点，共同推动公司产品的规划，赢得市场和客户。

3.2 如何赢得机会点

在对客户的项目及项目上的机会点进行了充分的挖掘和识别之后，接下来就是获得客户内部相关决策人员的同意，客户愿意在新项目中使用我们的芯片开展设计和验证，即赢得项目机会点或客户采用我们的芯片进行产品设计。通常情况下，赢得项目机会点的标志是客户口头承诺，或者以邮件等书面形式告知在新项目中将使用我们的芯片，或者直接使用我们的芯片进行终端产品的原理图设计。

赢得项目机会点是芯片销售过程中最为关键的一步，意味着打开了客户合作的大门，芯片销售可以进入门内，证明个人和公司的实力。这也是挑战最大的一步，赢得项目机会点的前提是得到客户相关方的全部同意，甚至还要参与客户的竞标等流程，过五关斩六将。本节将围绕如何赢得客户项目机会点，介绍相关的思考维度，供读者在实践中参考。

3.2.1 客户决策链及关键人梳理

赢得项目机会点的实现首先建立在对客户决策链的梳理，以及对决策链上关键人员的识别之上。只有对客户的决策链和关键人员有充分的了解之后，才能有的放矢地开展客户突破工作。无论是大客户还是中小型客户，面对项目上的新芯片产品需求，都有一套完整的决策链。在这个决策链上，我们在 3.1.1 节提到的客户内部的五种角色会在不同的决策时间点会参与进来，表达自己的看法，投出反对、中立或者同意的一票。

因此，芯片销售在争取某个客户的某个项目上的机会点时，一定要对客户的决策链按照决策流程的顺序进行梳理，罗列具体的决策人员。如果决策人员的上级会参与，要一并罗列。务必完整地展现客户的决策流程、决策人员以及决策时间点。芯片销售可以邀请自己的主管、对该客户有所了解或者以往支持过该客户的同事一起来审视自己的决策链梳理

4.1.2 “第一次客户拜访”的要点

第一次客户拜访是销售活动中常见的场景，也是最考验销售基本功的场景。对于已经熟悉的客户，销售人员在拜访前的准备以及与客户的沟通交流中，双方都有较大的容错空间，相对简单。交流双方的心态也比较放松随和。

然而第一次见面的客户通常都比较拘谨，表达比较保守，销售需要主动引导交流的节奏、内容等，以实现交流的高效和双方感受的愉悦。第一次拜访交流结束后，客户会对销售人员、芯片公司及产品形成第一印象，第一印象十分重要，奠定了客户后续的接触交流意愿。因此，第一次的客户拜访值得销售人员细心准备。

第一次客户拜访通常主要以双方人员互相熟悉为主，对公司及产品的介绍不宜过多，重点突出公司及产品价值点，让客户有个好印象。产品合作往往都建立在客户对销售人员、芯片公司熟悉和认可的基础之上。第一次拜访中，促成合作并不是主要目的。主要目的是让客户熟悉芯片公司的销售人员，了解芯片公司及产品的基本情况，让芯片销售人员理解客户的痛点和诉求，为后续的合作交流奠定基础。图 4.1 罗列了芯片销售第一次拜访的要点清单，供读者参考。

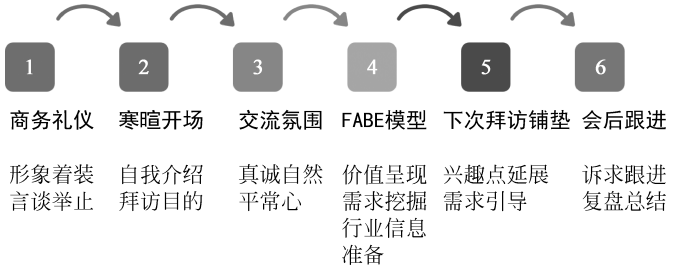


图 4.1 客户拜访要点

1. 商务礼仪

销售人员应充分重视个人形象，给客户留下可信任、有亲和力的印象，可以从发型、着装、言谈举止等方面进行自我审视。

着装可以依据拜访客户对象的不同，层级的不同有所区别，但整体把握的原则是简洁得体、自然大方、不浮夸、不出奇。例如，拜访客户的研发人员，着装可以休闲一些，避免让研发人员产生距离感。拜访客户的商务或者高层人员，着装应该稍许正式一些。总体的原则是，着装的风格可以向客户看齐，不要产生错配。试想一位西装革履的销售人员，出现在客户公司一位着休闲装的研发人员面前时，这样的氛围并不有利于拉进销售人员和客户之间的距离。

在言谈举止上，要做到基本的礼貌，整体的原则是考虑周全却不过度，不对客户造成压迫感，给客户以舒适的体验。比如，见到客户的时候，有的销售会展现得过于热情，滔滔不绝，虽然表达了自己对客户的重视或者感激，但也会给客户造成一定的压力，热情却不过度，是较好的原则，建议读者在实际工作中不断地训练，可以观察这方面做得出色的同事，学习模仿。

2. 寒暄开场

现在拜访客户，许多销售人员已经没有带名片的习惯了，联系方式的存留通常通过微

5.1 大客户的特点与挑战

大客户与中小规模的客户在供应商管理体系、供应商认证导入流程、供应商产品选择决策体系以及供应商产品导入流程等方面有显著的不同。芯片销售想要实现大客户的突破，首先必须对大客户的流程体系、合作挑战有清晰的认知和理解，从而能够有效地协调和调动芯片公司内部各个部门的资源，在满足客户体系和流程要求的前提下，找到机会点并实现突破，促成合作。

本节将围绕大客户的特点进行详细介绍，这些特点决定了大客户的导入难度。在实际的销售活动中，行业大客户往往具备这些特点，同时，个别的中等规模客户也具有这些特点。因此，芯片销售在面对具备这类特点的客户时，所面对的销售场景是复杂的。我们可以这样来定义复杂销售场景：在复杂销售场景中，芯片销售需要得到客户内部一系列人员的同意并通过相应的流程，才能作出采购决策。

复杂销售场景的特征首先是客户拥有多个合作供应商可以选择，其次是客户内部不同级别、不同职责的人员会参与决策，最后是客户内部的决策流程较为复杂，外部人员很难轻易理解。图 5.1 展示了大客户销售场景或复杂销售场景往往具有的四个特征。

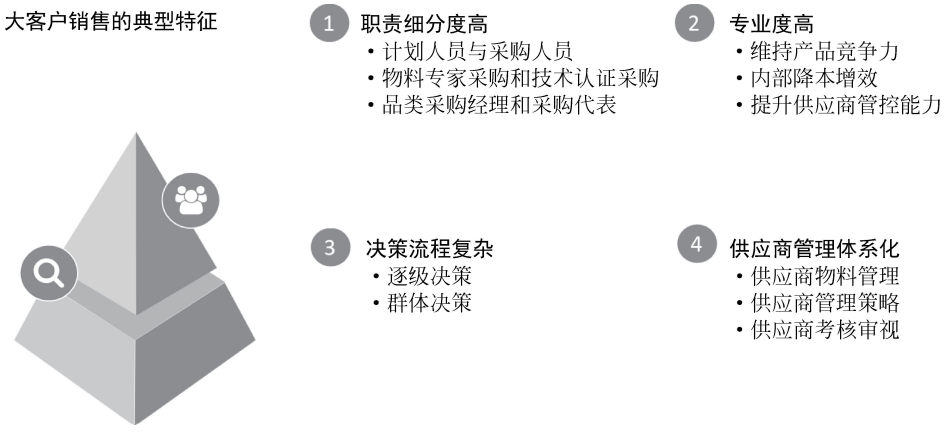


图 5.1 大客户销售的典型特征

5.1.1 职责细分度高

大客户或者说复杂销售场景的特征之一是客户内部人员的职责细分度很高。芯片销售通常主要接触客户内部的研发、采购和质量体系人员。中小规模客户内部的各个体系人员，往往一人兼具多种工作职责。而在大客户内部，往往一个职责对应一个人员，并且还会额外设置一些为实现内部流程精细化运营、管控产品性能及质量的岗位。

在激烈的市场竞争中，企业可以通过精细化的管理来提升自身的市场竞争力。细分职责可以确保企业的每个关键环节都有明确的责任人，减少内耗，提高内部协同效率。

我们从客户采购体系的职责细分角度出发，来比较中小规模客户和大客户的区别，以便读者对大客户内部的职责细分有一定的了解。

对于中小规模的客户而言，客户采购人员的主要任务是与供应商进行价格谈判，按照

续经营的风险。

除了财务上的考核以外，芯片供应商的研发人员背景及能力、研发人员数量、未来产品规划是否契合大客户的需求、目前芯片产品的出货量、合作客户群、质量管理体系和供应链布局等都可能是大客户对供应商考核审视的维度，尤其是新供应商。早期国内芯片公司的芯片产品，主要卖点之一是和海外供应商的芯片产品管脚兼容，方便客户在应用时直接替换，一些谨慎的客户还会审视供应商在知识产权等方面的法务风险。

与此同时，当芯片供应商想进入大客户的某个品类资源池，成为正式合格供应商时，大客户会对芯片供应商进行体系稽核，通过体系稽核是成为大客户正式合格供应商的前提条件。体系稽核不仅会审核芯片供应商是否具备完整的质量团队人员，还会审核是否具备完善的产品开发和质量管理体系、晶圆及封测等合作方的质量管理细则、质量管理的 IT 化等等。体系稽核往往会持续两到三天，芯片供应商内部的各个主要部门都会参与。一些大客户还会实地考察，走访芯片产品的生产商，也就是芯片设计公司合作的晶圆厂及封测厂。由于汽车芯片产品可靠性等要求比消费类芯片产品更高，因此，汽车市场的大客户的供应商审核项目会更多，要求也会更严格。

实际上，大客户的体系稽核是对芯片供应商的一次全面“体检”。只要能够按照大客户体系稽核的要求完善自身质量管理体系，芯片公司本身的质量管理能力也会有大幅度的提升。从长远看，这也是芯片公司成长发展的必备一环。众所周知，华为对供应商的体系稽核和质量要求是最为严格的，通过华为体系稽核认证的芯片公司，可以以此作为自身芯片产品质量的背书，其他市场的客户也认可这一结论。

对于已合作的芯片供应商，大客户也会对芯片供应商的质量、交付和公司运营状况等方面的表现，进行定期评分和审视。一旦发现风险，会立即调整业务合作的范围和内容，从而确保供应商体系的健康度。大客户往往还会在每年的供应商大会上，对在交付、质量和产品创新等方面有优异表现的供应商颁奖。

5.2　大客户突破的关键点

在 5.1 节中，我们集中介绍了大客户的典型特征，包括职责细分度高、专业度高、决策流程复杂和供应商管理体系化。因此，想要突破大客户，获得合作机会，必须以大客户的特征为核心，制定产品和销售策略。

在 3.2 节中，围绕如何赢得客户项目机会点并获得客户的使用承诺，我们已介绍了客户决策链及关键人梳理、自身优劣势评估维度以及关键的行动事项，这三点内容无论对于大客户还是中小客户都有适用性。那么针对大客户的突破，在赢得客户项目机会点（实现 DIN）、赢得客户项目（实现 DWIN）等方面，有哪些方面需要特别关注，并且需要更加深入地洞察呢？在这一节中，我们针对大客户的突破，总结关键点供读者参考。这些关键点对于中小客户可能是优选项，但对于大客户会是必选项，甚至是关键项。

5.2.1　分析客户的接受度

对于大客户，芯片销售需要更加深入地分析不同客户人员对于我们产品和方案的感知及接受度。这里的不同客户人员包括我们在 3.1 节中提到的，参与客户项目的不同角色人